

Free Height

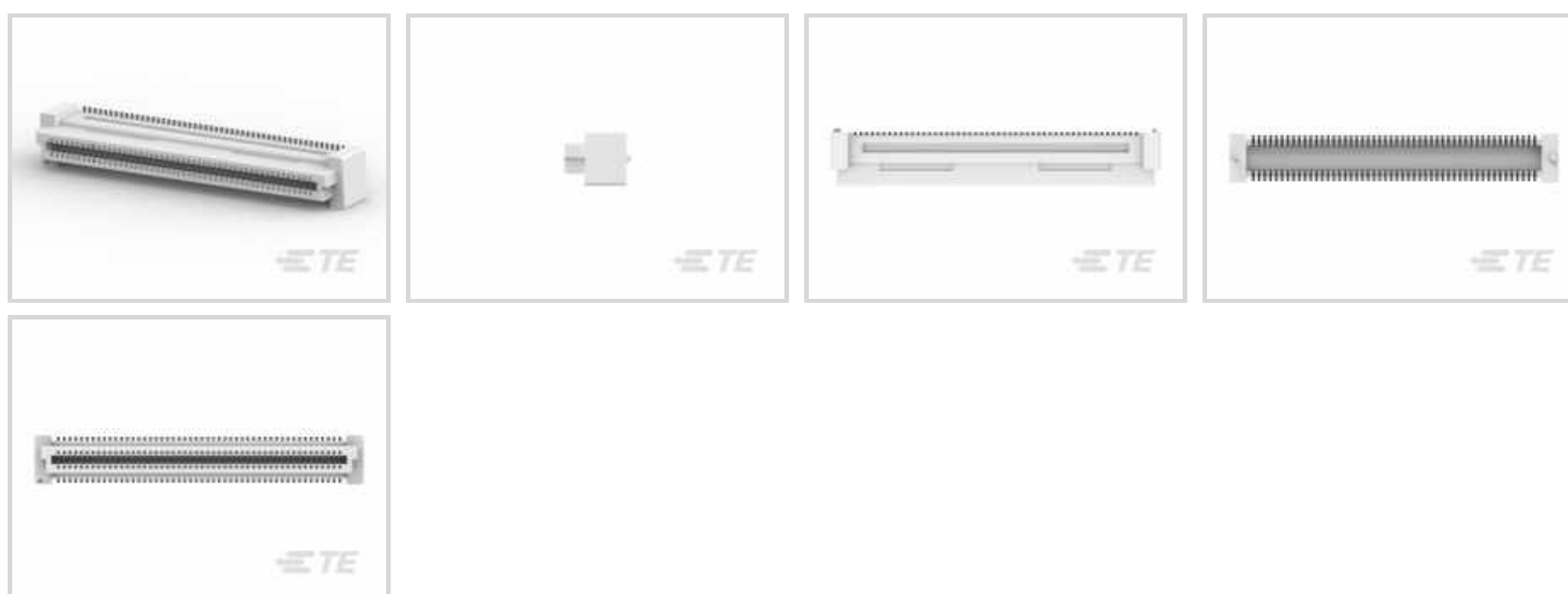
Interne TE-Nummer 5-5179009-4

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 100 Position, .8 mm [.031 in] Centerline, Gold, Surface Mount, Signal, Natural, Free Height

[Auf TE.com ansehen>](#)

Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen >

FH-Buchsensteckverbinder: Leiterplatte-an-Leiterplatte, vertikal, 100, 0,8 mm

PCB-Steckverbindermontagetyp: **Buchse für die Leiterplattenmontage**Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**Anzahl von Positionen: **100**Raster: **.8 mm [.031 in]**[Alle FH-Buchsensteckverbinder: Leiterplatte-an-Leiterplatte, vertikal, 100, 0,8 mm \(24\)](#)**Eigenschaften****Produktmerkmale**

PCB-Steckverbindermontagetyp	Buchse für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Stapelbar	Ja
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	100
Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration	Parallel

Elektrische Kennwerte

Spannungsfestigkeit (max.)	500 VAC
Isolierwiderstand	2 MΩ

Arbeitsspannung	100 VAC
-----------------	---------

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Naturbelassen
----------------------	---------------

Kontaktmerkmale

Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	2 µm[78.74 µin]
Kontaktaufbau	Verbindungsuffe
Flachkontaktbreite	.4 mm[.016 in]
Flachkontaktdicke	.2 mm[.008 in]
Oberfläche des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Matt
Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers	Matt
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.2 µm[8 µin]
Kontakttyp	Stecksockel
Kontakt-nennstrom (max.)	.5 A

Klemmenmerkmale

Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke	.2 mm[.008 in]
Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite	.3 mm[.012 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Oberflächenmontage

Montage und Anslusstechnik

Länge der Montageführungsfunktion	.5 mm[.02 in]
Montageausrichtungstyp für Leiterplatte	Fixiernaben
Gegensteckführung	Mit
Typ der Gegensteckführung	Polarisierung
Arretierung für Leiterplattenmontage	Ohne
Montageausrichtung der Leiterplatte	Mit
Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Steckeingangsposition	Oben
Raster	.8 mm[.031 in]

Gehäusematerial	Matt
-----------------	------

Abmessungen

Steckverbinderhöhe	9 mm [.354 in]
Stapelhöhe	9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm [.354 in][.394 in][.433 in][.472 in]

Verwendungsbedingungen

Gehäusenennntemperatur	Hoch
Betriebstemperaturbereich	-40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

Betrieb/Anwendung

Satzverarbeitungsfunktion	Keine
Stromkreis Anwendung	Signal

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

Verpackungsmerkmale

	.5 in
Verpackungsmenge	10
Verpackungs-Typ	Kasten, Rohr

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023 (235) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2023 (235) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Reflow-Löten tauglich bis 260 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | Free Height



Kunden kauften auch diese Produkte





Dokumente

Produktzeichnungen

0.8FH,R09H.5,100,08/Sn,TU

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5-5179009-4_A.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5-5179009-4_A.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_5-5179009-4_A.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

Fine Pitch Stacking Connectors - 0.8mm Free Height (FH) Connectors

Englisch

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Englisch

Produktspezifikation

Englisch